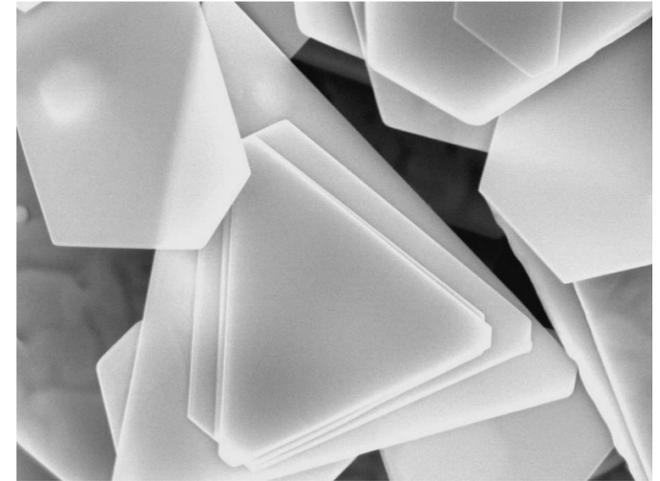


トクセン独自形状の超微細銀粉末

特長

- ・単結晶構造により高い導電性、熱伝導性が得られます。
- ・低温焼結特性により、高い導電性、接着力が得られます。
- ・平滑な形状特性により、高い反射性、潤滑性が得られます。
- ・薄型、微細なサイズ特性により、高精度印刷に対応できます。



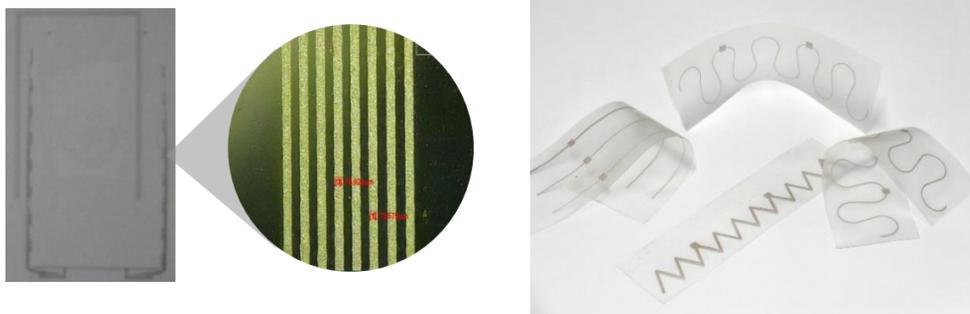
用途例 1

<電子材料・半導体分野>

導電性ペースト用フィラー (電子材料の配線用)

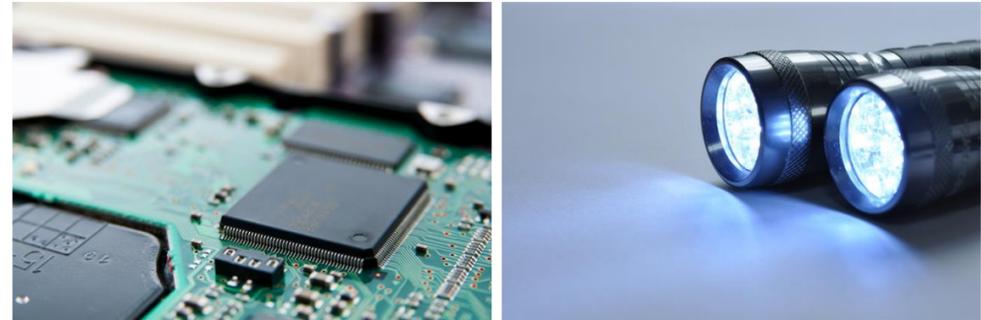


電子機器に使用される配線の導電体として、機器の高性能化、小型化に欠かせない材料として使用されています。

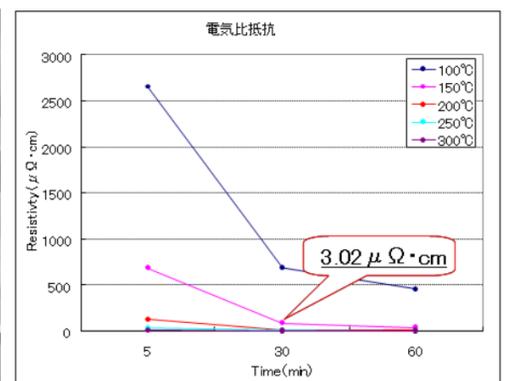
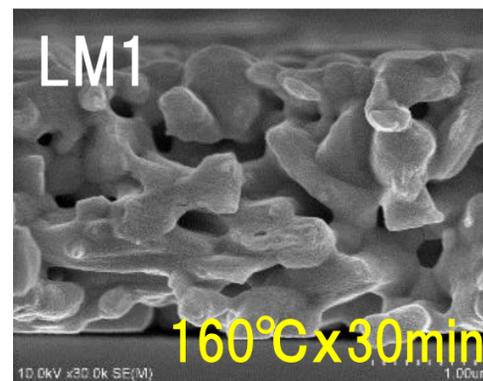


微細で高精度な印刷パターンに対応し、平滑な形状特性によりフレキシブルな印刷パターンにも対応します。

導電性接着剤用フィラー (電子部品の接合、放熱用)



高い信頼性の要求される電子材料の接着剤の導電、放熱材料として使用されています。

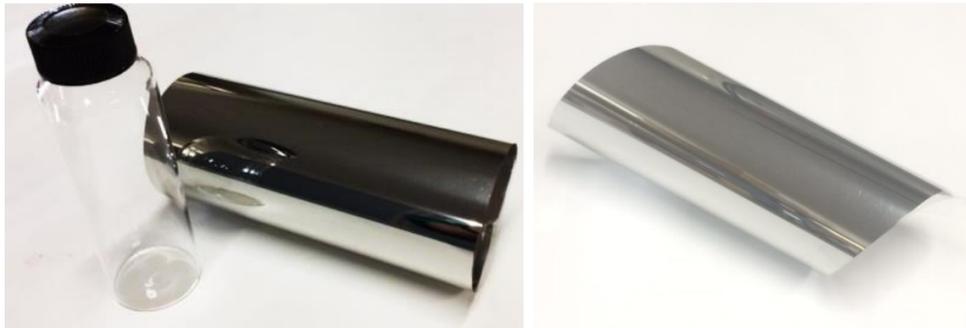


低温焼結により高導電性、高接着力を実現。

用途例 2

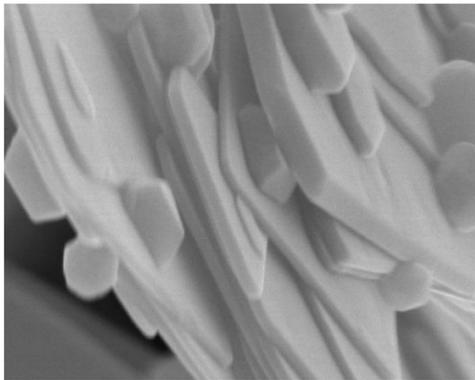
<塗料・機能性材料分野>

メタリック、鏡面塗料



平滑なサイズ特性により、銀本来の光沢、鏡面性が期待できます。

潤滑、機能性塗料



平滑なサイズ特性により高い潤滑性が期待できます。

その他用途への応用

平滑、薄型な形状特性を活かした様々な用途への応用が期待されています。

その他特長



有機溶媒、水分散(溶媒選択可)、粉状での提供が可能です。

銀の表面を有機コーティングする事により、親水性、疎水性のコントロールが可能です。

品質特性

品番	N300	M13	M27	LM1
D10(μm)	-	0.5 ≤	1.0 ≤	-
D50(μm)	0.4 ± 0.1	2.0 ± 0.5	4.5 ± 1.0	1.0 ± 0.3
D90(μm)	-	4.8 ≥	10.0 ≥	3.6 ≥
焼結温度(°C)	180°C x 30分	200°C x 30分	200°C x 30分	160°C x 30分
抵抗値(μΩ・cm)	4.0	3.6	4.2	4.9

